

**ULVAC**

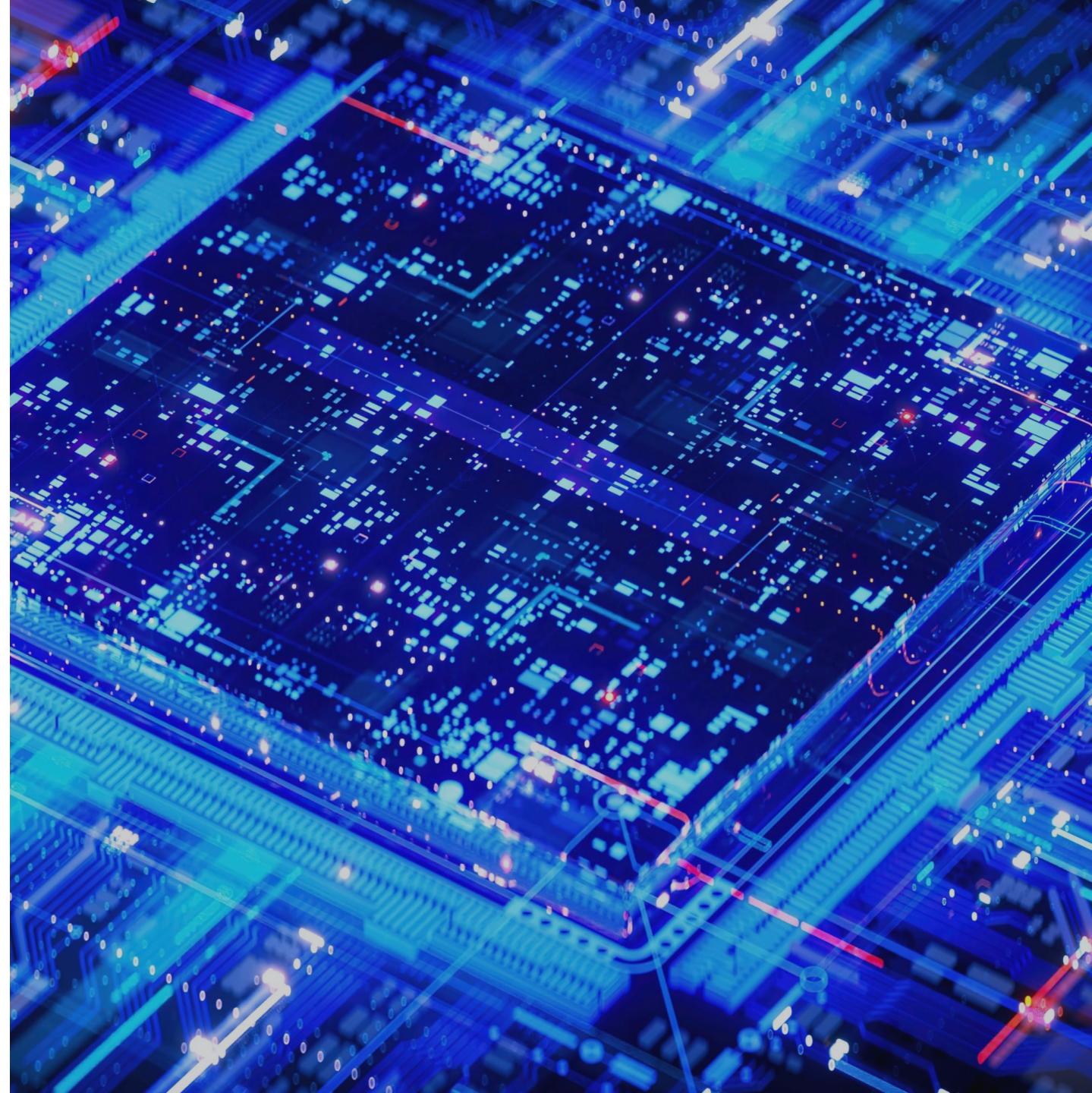
**株式会社 アルバック**

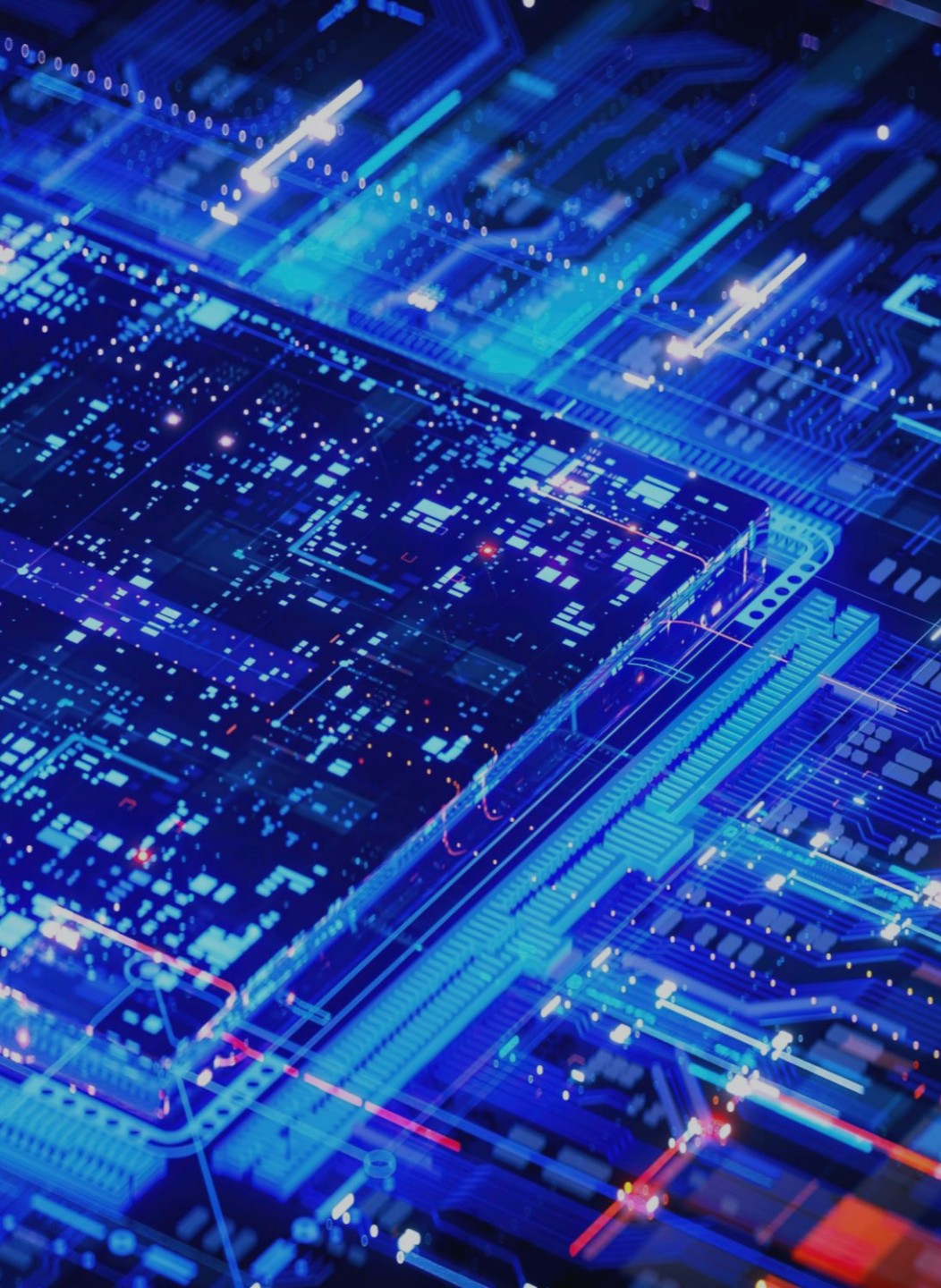
**2024年6月期 第2四半期  
決算説明資料**

---

**2023年7月～2023年12月**

**2024年2月13日**





## 将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

## 受注高・売上高ともにパワーデバイス増加・バッテリー関連活発化等により、前年同期比増加

- 半導体 : メモリ・先端ロジック投資抑制継続も、下期からの投資回復を見込む
- 電子 : SiCパワーデバイス投資活発化
- F P D : EVバッテリーの量産投資本格化

## 上期計画比でも受注高・売上高・営業利益（率）ともに計画を上回り、下期も堅調に推移する見込み

【単位：億円】	23/6期 1H	24/6期 1H	前年同期比	24/6期 1H計画	計画比
受注高	1,291	1,340	+4%	1,310	+2%
売上高	1,114	1,202	+8%	1,135	+6%
営業利益	105	103	-2%	80	+29%

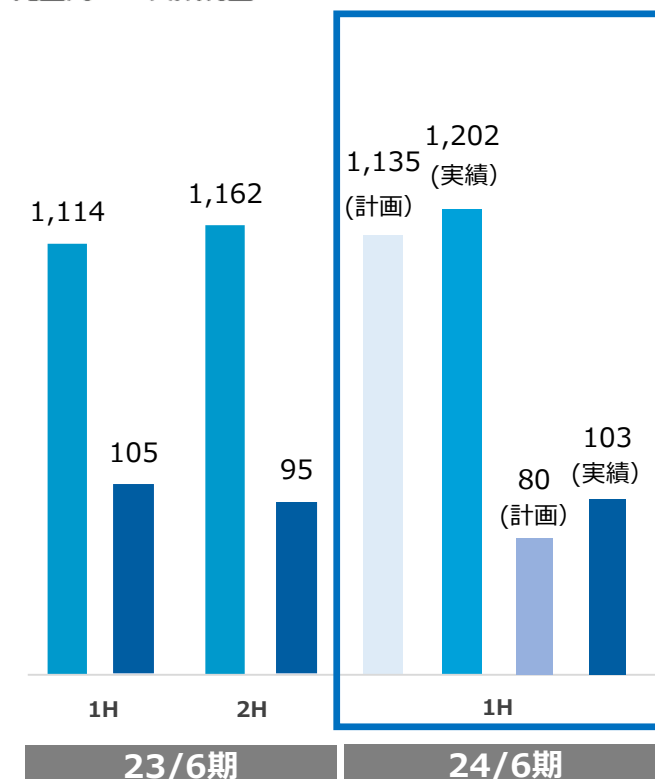
- 受注高・売上高ともにパワーデバイス増加・バッテリー関連活発化等により、前年同期比増加
- 受注高・売上高・営業利益（率）ともに上期計画を上回る

【単位：億円】	23/6期 1H	24/6期 計画			24/6期1H実績				
	実績	1H	2H	通期	実績	前年同期比	計画比		
受注高	1,291	1,310	1,190	2,500	1,340	+49	+4%	+30	+2%
売上高	1,114	1,135	1,315	2,450	1,202	+88	+8%	+67	+6%
売上総利益	333	-	-	-	354	+21	+6%	-	-
率	29.9%	-	-	-	29.4%	-0.5pt	-	-	-
販管費	228	-	-	-	250	+22	+10%	-	-
営業利益	105	80	150	230	103	-2	-2%	+23	+29%
率	9.4%	7.0%	11.4%	9.4%	8.6%	-0.8pt	-	+1.5pt	-
経常利益	118	90	155	245	110	-8	-7%	+20	+22%
率	10.6%	7.9%	11.8%	10.0%	9.1%	-1.4pt	-	-	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	93	55	105	160	69	-24	-26%	+14	+25%
率	8.4%	4.8%	8.0%	6.5%	5.7%	-2.7pt	-	+0.9pt	-

## 売上高と営業利益計画比

【単位：億円】

■ 売上高 ■ 営業利益



- 2Qは1Q比売上増加により売上総利益率・営業利益率ともに改善

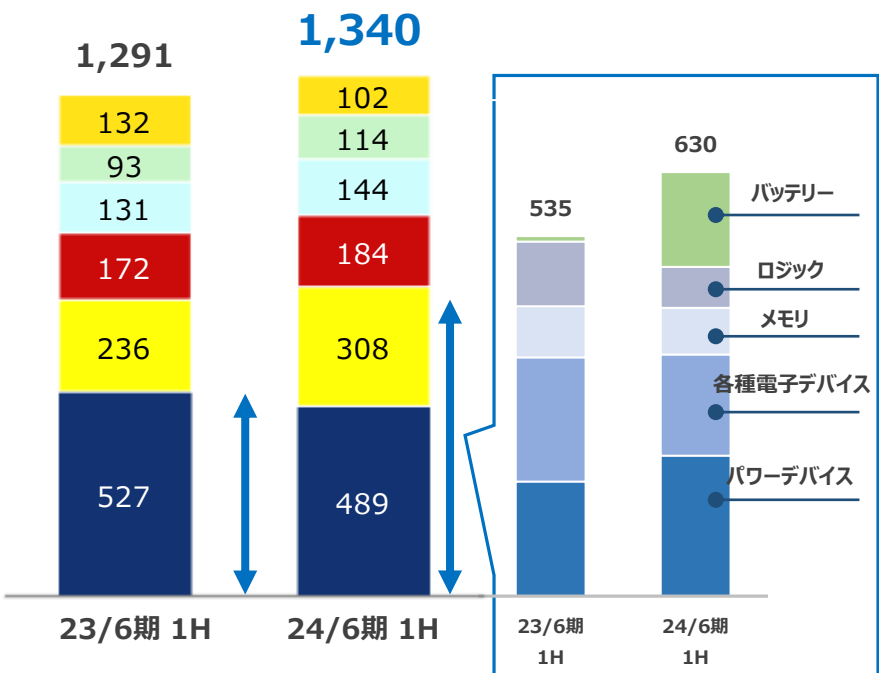
【単位：億円】	23/6期				24/6期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前年同期比	
							増減額	増減率
受注高	666	625	434	747	780	561	-64	-10%
売上高	562	552	496	666	550	652	+100	+18%
売上総利益	165	168	147	191	153	201	+33	+19%
率	29.3%	30.5%	29.7%	28.7%	27.7%	30.8%	+0.3pt	-
販管費	113	115	125	119	124	126	+11	+10%
営業利益	51	53	23	72	28	75	+21	+40%
率	9.1%	9.7%	4.6%	10.8%	5.1%	11.5%	+1.8pt	-
経常利益	52	65	39	72	29	81	+15	+24%
率	9.3%	11.8%	7.8%	10.8%	5.3%	12.4%	+0.5pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	41	53	24	24	11	57	+4	+8%
率	7.2%	9.6%	4.9%	3.6%	2.1%	8.8%	-0.8pt	-

# 3 受注高・売上高ともに前年同期比増加

- 受注高はパワーデバイス増加・バッテリー関連活発化等により、前年同期比増加
- 売上高はパワーデバイス等半導体電子の貢献、高水準の受注残高の寄与等により、前年同期比増加

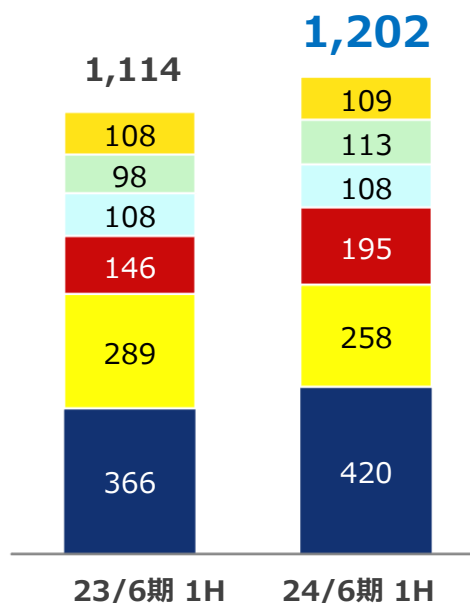
## 受注高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料  
■ FPD製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他



## 売上高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置    ■ コンポーネント    ■ 材料  
■ FPD製造装置    ■ 一般産業用装置    ■ その他



## 半導体・電子

### 半導体

メモリ・先端ロジック投資抑制継続も、下期からの投資回復を見込む

### 電子部品

パワーデバイス：SiC投資活発化

各種電子デバイス：技術革新・増産投資継続

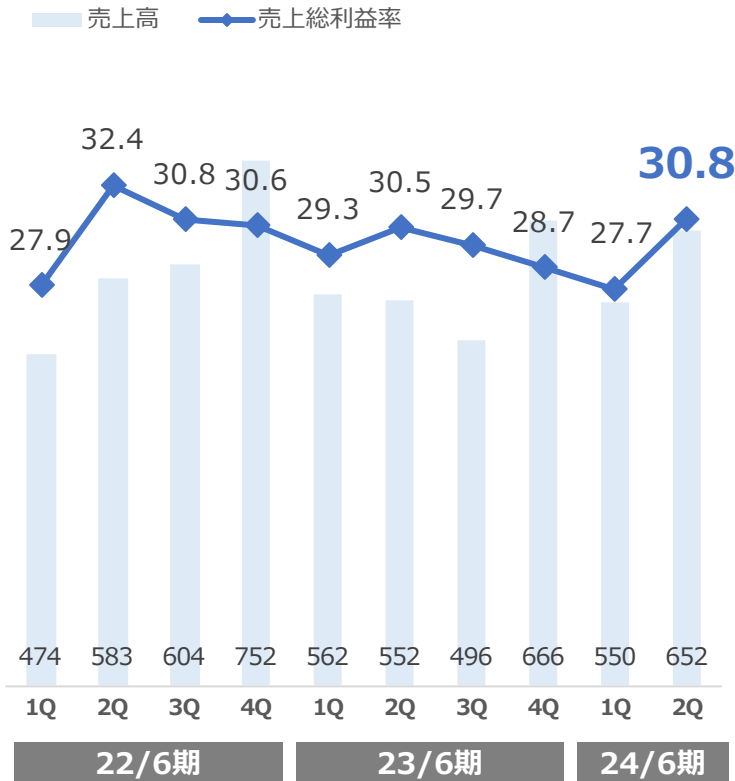
## FPD

EVバッテリーの小型大容量化、安全性向上に向けた量産投資が本格化

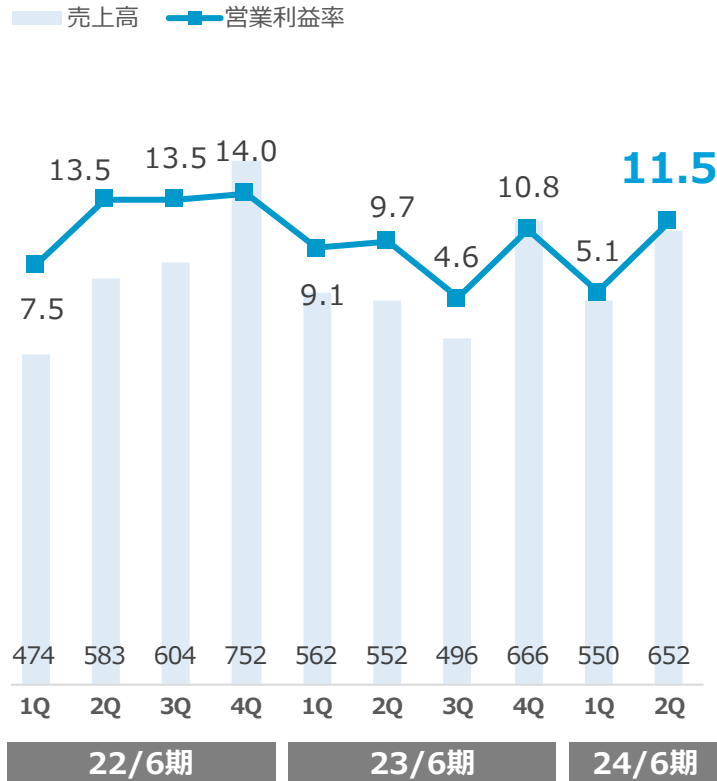
# 4 2Q売上総利益率・営業利益率ともに改善

- 2Qの売上総利益率・営業利益率は売上高増加に伴い改善

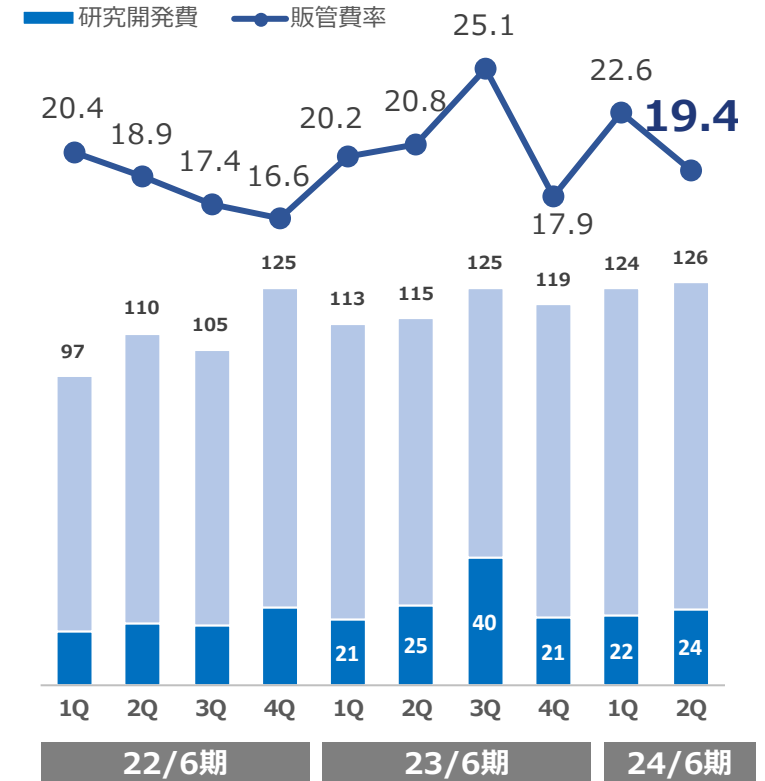
## 売上総利益率 【単位：億円、%】



## 営業利益率 【単位：億円、%】

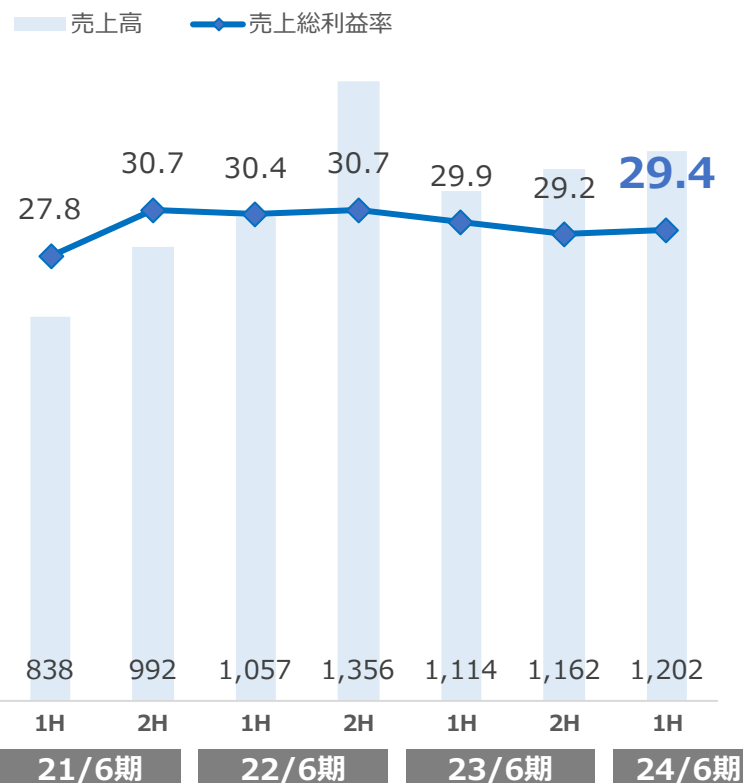


## 販管費(率)推移 【単位：億円、%】



- 売上総利益率・営業利益率は売上高増加に伴い改善

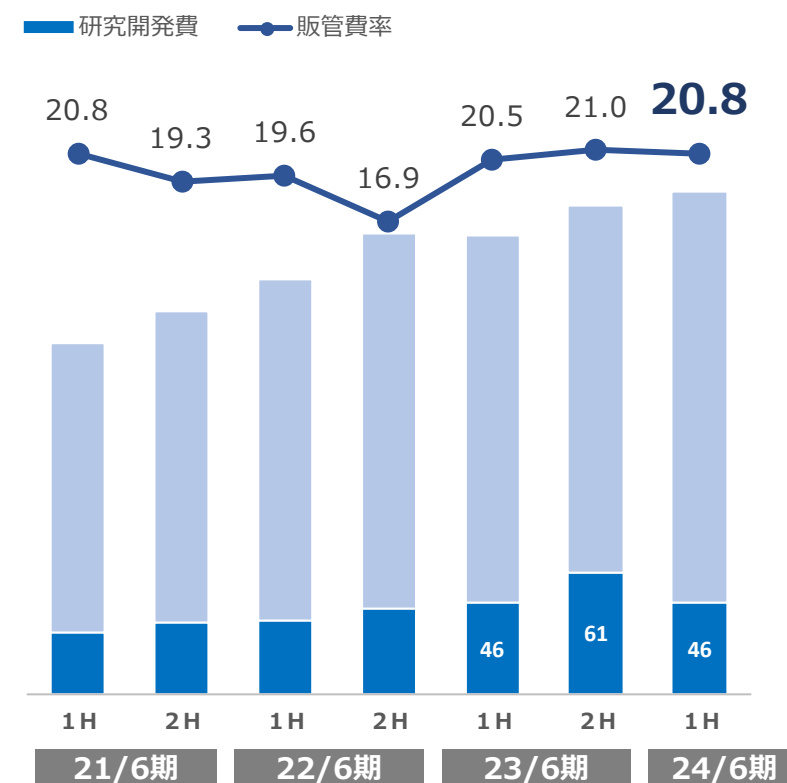
## 売上総利益率 【単位：億円、%】



## 営業利益率 【単位：億円、%】

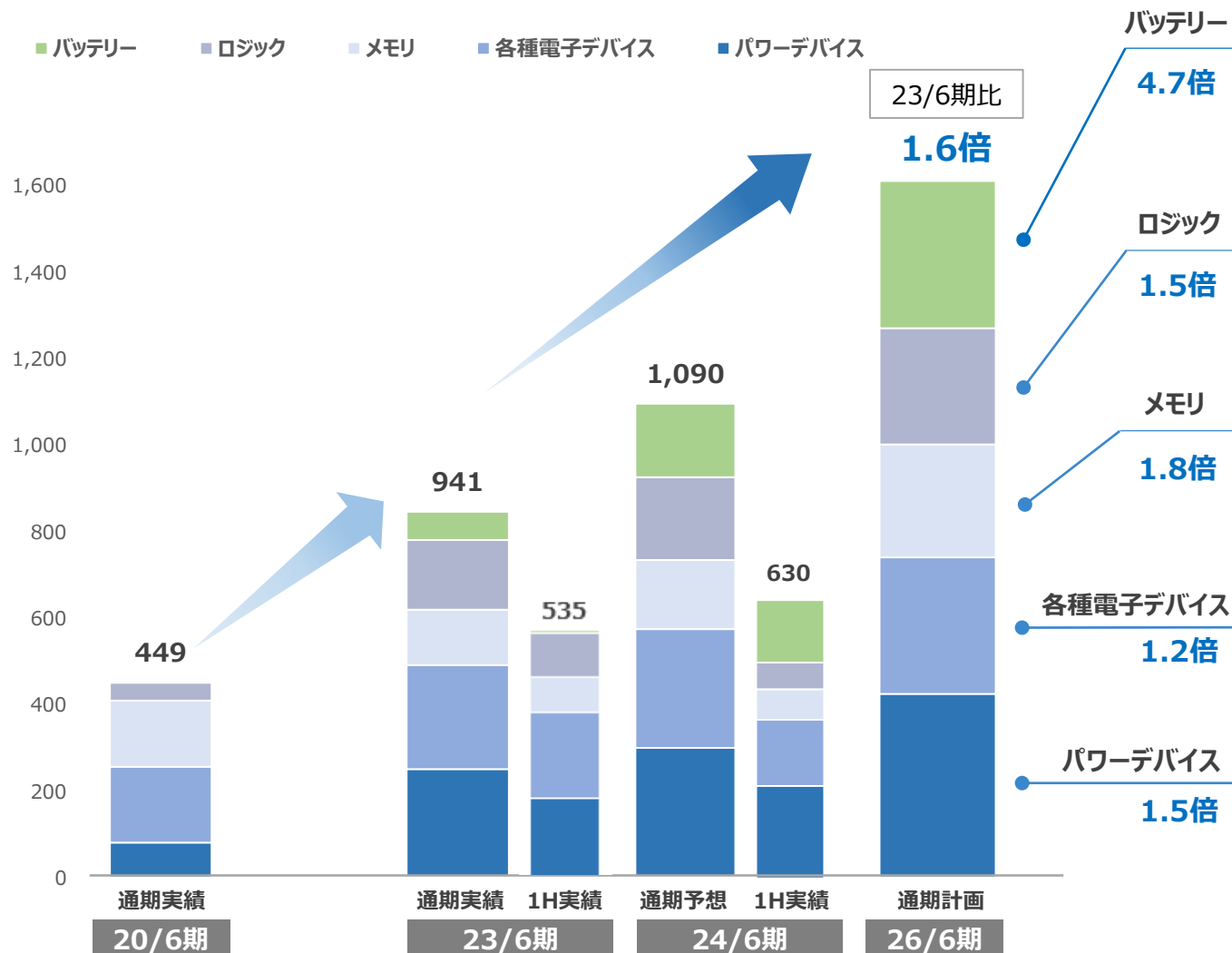


## 販管費(率)推移 【単位：億円、%】





## 成長ドライバーの受注推移 【単位：億円】



> EVバッテリーの正極集電体のアルミ両面蒸着膜への第1次投資が本格化

⇒ 第1次投資稼働後の拡大投資で更なる成長を見込む

> 先端ロジック投資は調整局面から投資回復局面に

> 上期にMHM（メタルハードマスク）工程で3社目の採用確定

⇒ MHM工程に加え、新工程で成長

> メモリ投資も調整局面から投資回復局面に

> HBM（ハイバンドメモリ）関連投資が寄与

⇒ DRAM・NAND投資回復に加え、新工程参入で成長

> 各種電子デバイスは技術革新・増産投資継続

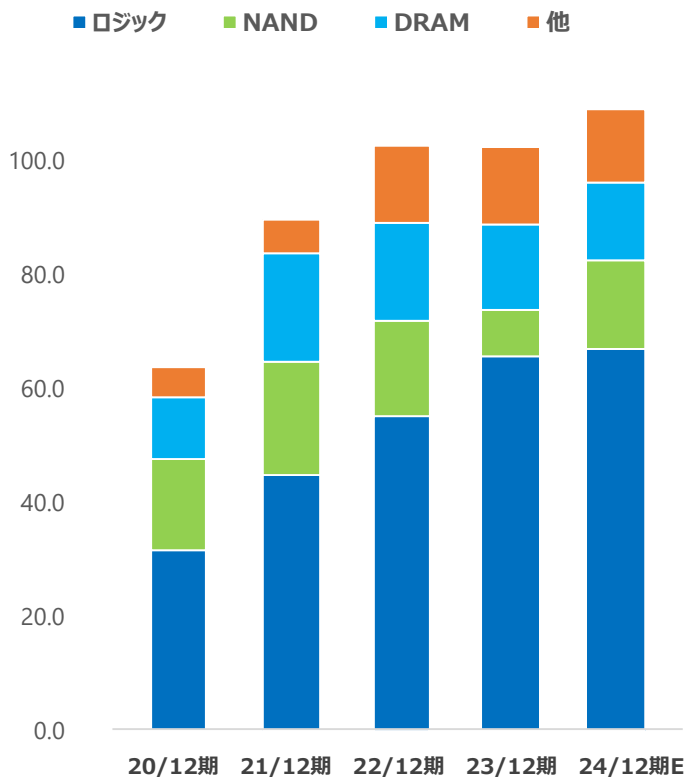
⇒ 微細化の限界への対応・省エネ化のためのパッケージング投資等活発化

> パワーデバイスは日本・中国でSiC投資活発化（8インチ投資は来期以降本格化見込み）

⇒ グリーンエネルギー化・EV化による需要増、SiC投資（ウェハーサイズアップ・トレンチ構造化）で成長継続

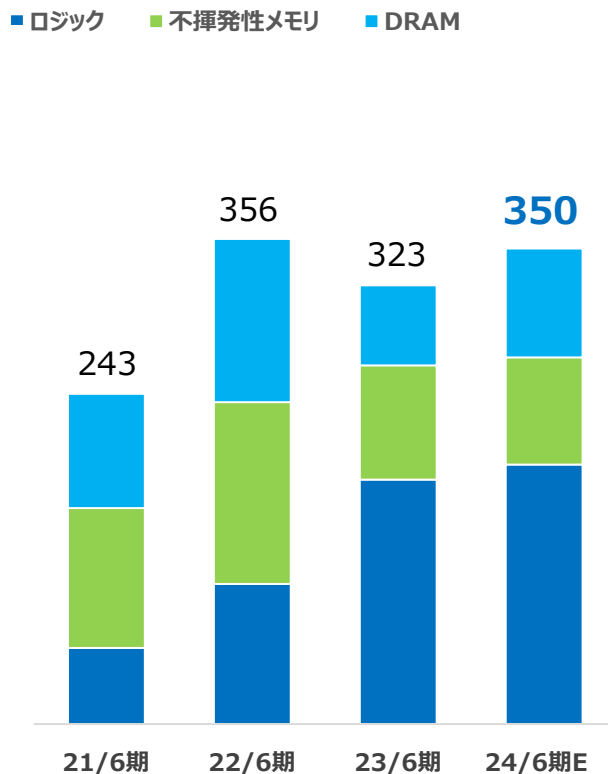
- メモリ・先端ロジック投資は調整局面から投資回復局面に
- 中長期的な投資拡大傾向に変わり無く、メモリ・先端ロジックの投資回復、新工程参入により成長を見込む

## 半導体設備投資予測 【単位：bnUS\$】



出所：SEMI

## 受注推移 【単位：億円】



## 今期受注

### メモリ

- 調整局面から投資回復局面に
- HBM関連投資が寄与

### ロジック

- 調整局面から投資回復局面に

## 来期以降

### メモリ

- 投資回復に加え、新工程参入で成長

### ロジック

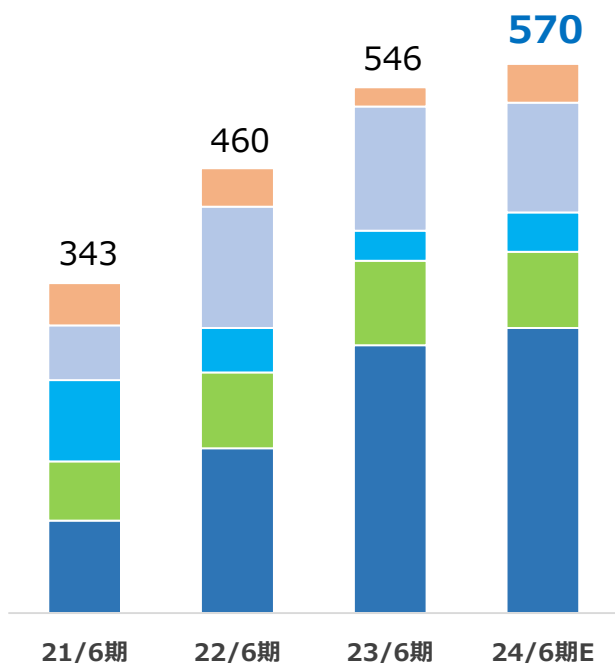
- 先端ロジック（MHM工程）投資回復・新工程参入により成長

- パワーデバイスは日本・中国で投資拡大継続
- 来期以降もパワーデバイス・各種電子デバイス等の成長継続

## 受注推移（分野別）

【単位：億円】

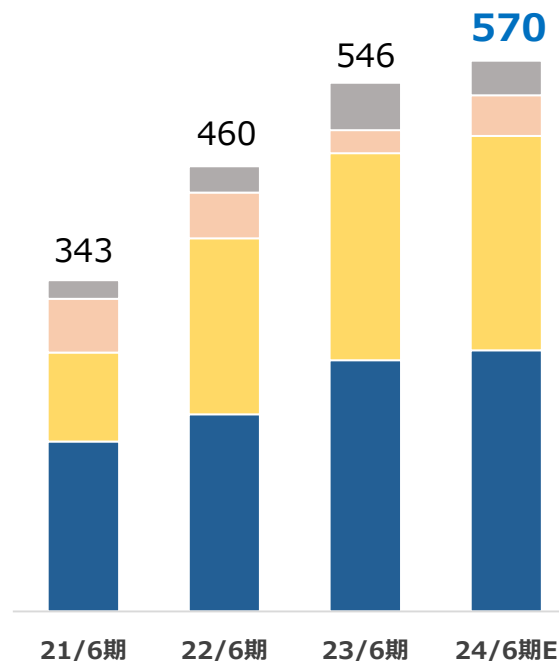
- パワーデバイス
- 通信デバイス
- パッケージング
- オプトデバイス
- 電子部品（MEMS）



## 受注推移（地域別）

【単位：億円】

- 日本
- 中国
- 台湾
- その他



## 今期受注

### パワーデバイス

- 日本・中国のSiC投資（6インチ）が活発化

### 各種電子デバイス

- 微細化の限界への対応・省エネ化のためのパッケージング投資等活発化
- 技術革新・増産投資継続

## 来期以降

- グリーンエネルギー化・EV化進展、中国の国産化政策、SiC（8インチ）投資本格化等により、パワーデバイスの高水準の投資継続
- スマート社会化・デジタル化＋メタバース等に伴い、各種電子デバイスの投資継続

- 今後のパワーデバイス投資の中心はSiC

⇒ SiC基板サイズアップ（6→8インチ）、SiC構造変化（プレーナ→トレンチ）によりビジネスチャンス拡大

23/6期比**1.5倍**

23/6期

24/6期

25/6期

26/6期

【技術トレンドと強み】

SiC基板サイズアップ

6インチ

8インチ



スパッタリング装置

高価で反りの大きいSiC基板  
⇒基板搬送技術・応用制御による  
反りコントロール



イオン注入装置

基板が硬いSiCには高温/低温・複数回の  
イオン注入要  
⇒レシピ切替により1台で高生産性実現

構造変化

プレーナ

トレンチ



蒸着装置

現地生産による低価格で  
生産性の高い装置



エッチング装置

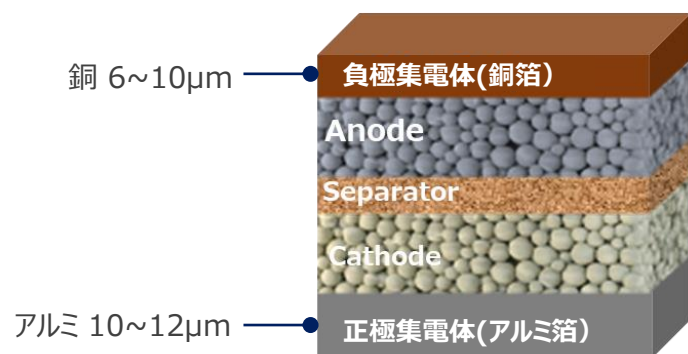
チャネル抵抗・電力ロスが低いトレンチ  
構造を実現する加工形状制御  
(側壁の平準化・角部のラウンド化)

Si-MOSFET

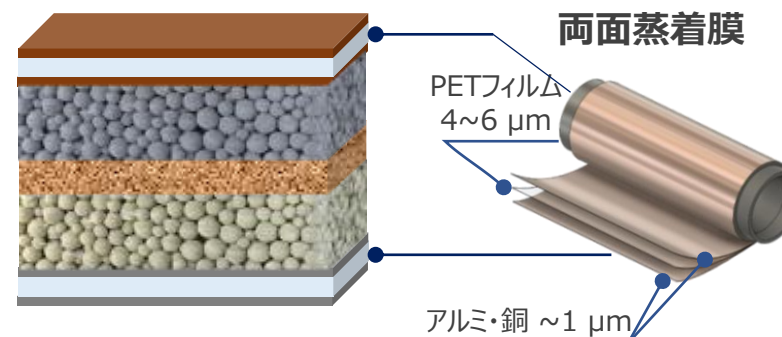
- 両面蒸着膜正極集電体(CCC)は第一次投資本格化
- 両面蒸着膜負極集電体(ACC) で中期的な成長を目指す

両面蒸着膜効果	正極集電体 (CCC) :アルミ	負極集電体 (ACC) :銅	強み
□ 安全性向上	◎	◎	・ フィルムの溶断で熱暴走抑制
□ 小型軽量化	◎	◎	・ 走行距離延長(18%)
□ 部材コスト低減	○	◎	・ アルミ・銅使用量削減(1/5程度)
□ GHG削減	◎	○	・ アルミ使用量減による温室効果ガス削減(20%)

液系リチウムバッテリー  
基本構造

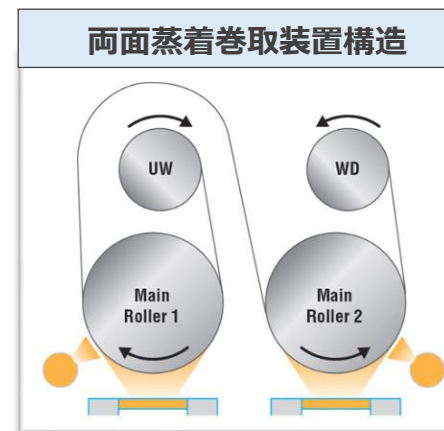
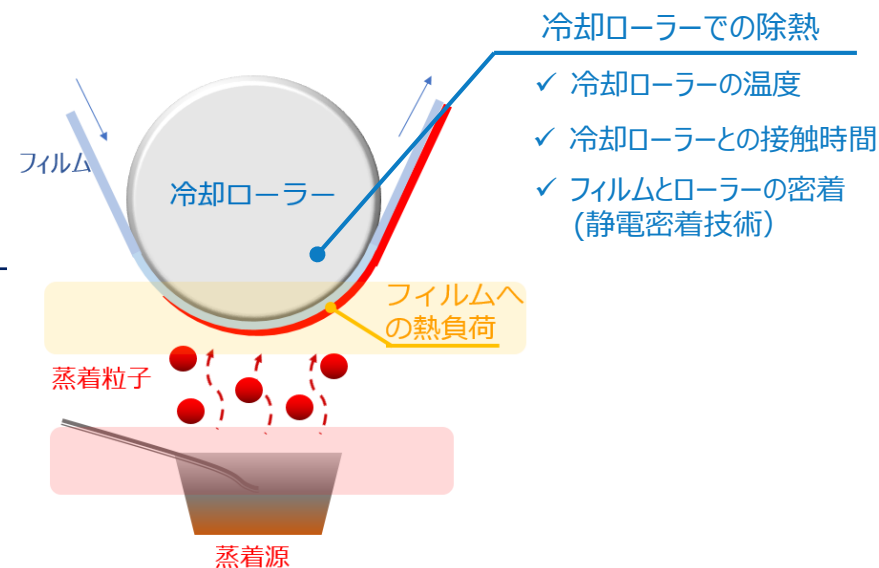
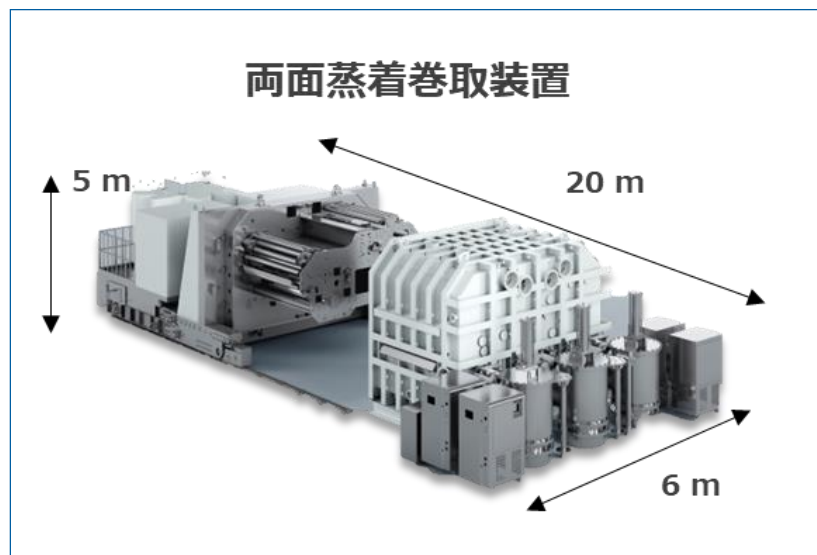


両面蒸着膜



## アルバックの強み

- 1 車載用フィルムキャパシタ向け蒸着巻取装置（片面成膜でシェア9割以上）で培った技術力・信頼性
- 2 熱ダメージ抑制による高速長尺成膜実現
- 3 両面一括・1回成膜による高い生産性で差別化（他社は片面で数回要す）  
⇒ 今後は広幅化で更に生産性向上



シワや破れが発生！



フィルムへのダメージ無く成膜可

23/6期比**4.7倍**

22/6期

23/6期

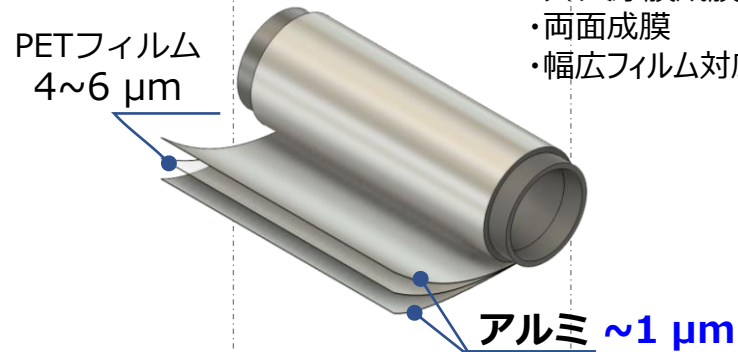
24/6期

25/6期

26/6期

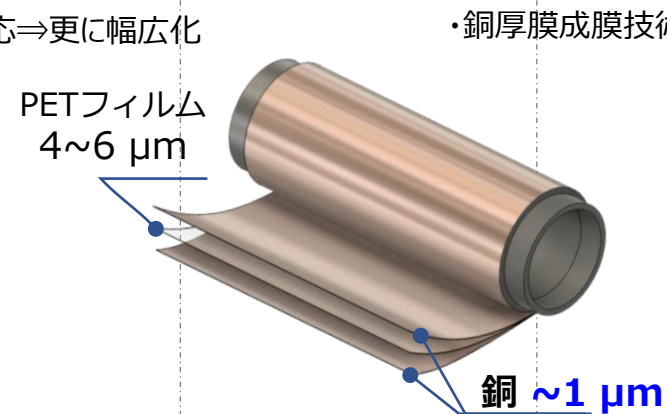
27/6期

## 両面蒸着膜 正極集電体(CCC)



- ・アルミ厚膜成膜技術
- ・両面成膜
- ・幅広フィルム対応⇒更に幅広化

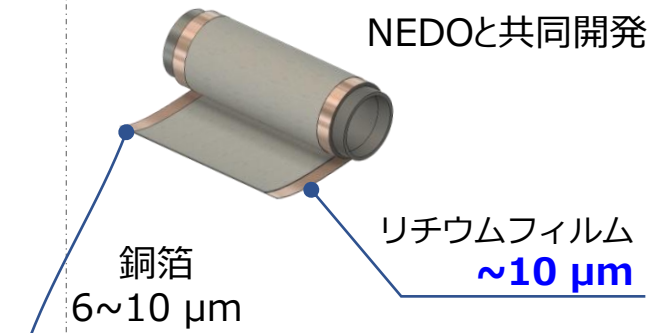
## 両面蒸着膜 負極集電体(ACC)



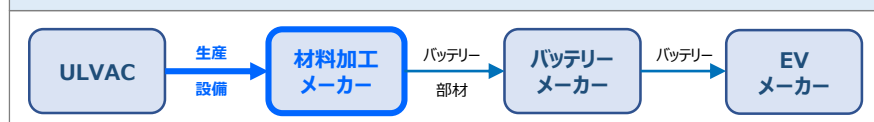
- ・銅厚膜成膜技術

## 負極(Anode)

- ・金属箔搬送技術
- ・リチウム金属成膜技術



## CCC/ACC等のバッテリー部材のサプライチェーン



## コンポーネント

(上期：前年同期比**1.1倍**)



ヘリウムリークテスト装置

- EV向けリチウムバッテリー用中大型ポンプ、リークディテクター等が堅調
- 自動車・空調冷凍機分野用ヘリウムリークテスト装置が中国で堅調
- ITパネル用OLED投資向けクライオポンプが貢献見込み

## マテリアル

(前年同期比**1.2倍**)



半導体向け  
W スパッタリングターゲット

- パワーデバイス稼働率堅調に加え、FPD関連稼働率回復により堅調
- 半導体関連稼働回復見込み
- 先端半導体向け高品質焼結ターゲット（W・WSi）シェア拡大等により成長を目指す

## カスタマーサポート

(前年同期比**1.1倍**)



- FPD関連稼働率回復に伴い、部品販売・洗浄・表面処理等が堅調
- パワーデバイス等、電子部品関連の生産効率改善提案型ビジネスが増加
- 産業機器関連等も堅調



## TSMC社より2023 EXCELLENT PERFORMANCE AWARDにおいて「Excellent Production Support」表彰を受賞

アッシング装置の計画通りの納入、迅速・確実な現地インストールにより、TSMC社の事業成長に大きく貢献したことが認められ「Excellent Production Support」表彰を受賞しました。



## 統合レポート VALUE REPORT 2023を発行

持続的成長と企業価値向上に向けた取り組み、中長期的に目指す姿、経営姿勢を総括し、「ULVAC VALUE REPORT」を発行しました。



(日本語版)

### ULVAC VALUE REPORT 2023 目次

#### 読者の皆様に伝えたいこと

5 トップメッセージ

#### ULVACとは

9 ULVACの価値創造<事業価値>  
ココモ、アル。

11 ULVACの事業

13 ULVACの軌跡

#### ULVACが目指すもの

15 ULVACの価値創造<プロセス><注力課題>

19 ULVACの強み

21 ULVACのサステナブル経営

23 2050年にありたい姿の実現に向けて

25 新中期経営計画(2020年度~2022年度)の振り返り

26 新中期経営計画(2023年度~2025年度)

#### 目指す姿を実現するために

29 真空機器事業 ■ 半導体製造装置 ■ 電子部品製造装置

■ PFC製造装置 ■ コーポレート

■ 一般産業用装置

34 真空応用事業 材料

35 マテリアリティに関する取り組みの詳細

37 真空技術をコアとしたイノベーションの創出・共創の推進

41 多様な人材の育成と活躍推進(レジェンドを組織づくり)

45 パリチェーンにおける人権尊重、責任ある行動

49 持続可能な地球環境への貢献

#### コーポレートガバナンス

55 コーポレートガバナンス

59 社外取締役委員会

63 マネジメント体制

65 リスクマネジメント

67 コンプライアンス

68 ステークホルダーの皆様とともに

#### 財務データ/企業情報

69 11ヶ年財務・会計データ

71 財務概況

73 連結財務諸表

77 会社データ/株式情報

編集方針  
持続的成長と企業価値向上に向けた会社の1年間の取り組み、中長期的に目指す姿、経営姿勢を総括し、「ULVAC VALUE REPORT」として発行しています。  
この報告はステークホルダーの皆様にご覧いただくとともに、対話を通じた重要なツールと位置付けています。

■発行:  
2023年11月(前版発行2022年11月)  
■参考にした資料:  
IFC 国際統合報告フレームワーク  
経済産業省 価値創造がインテンス ISO26000

対象期間と範囲  
■対象範囲: アルパックグループ  
本レポートにおいて、ULVACグループ全体を指す場合は「ULVAC」、株式会社アルパックを指す場合は「アルパック」と表記しています。  
■対象期間: 2023年8月期  
(2022年7月1日~2023年6月30日: 当社2022年度)  
報告の一部に、2023年7月以降の活動と取り組み内容も含まれます。

(免責事項)  
本レポートに記載されている数値やグラフの数値は、四捨五入して表記しているため、合計値と異なる場合があります。また、対象範囲の拡大や集計方法の変更に伴い、一部数値がデータ修正している箇所があります。

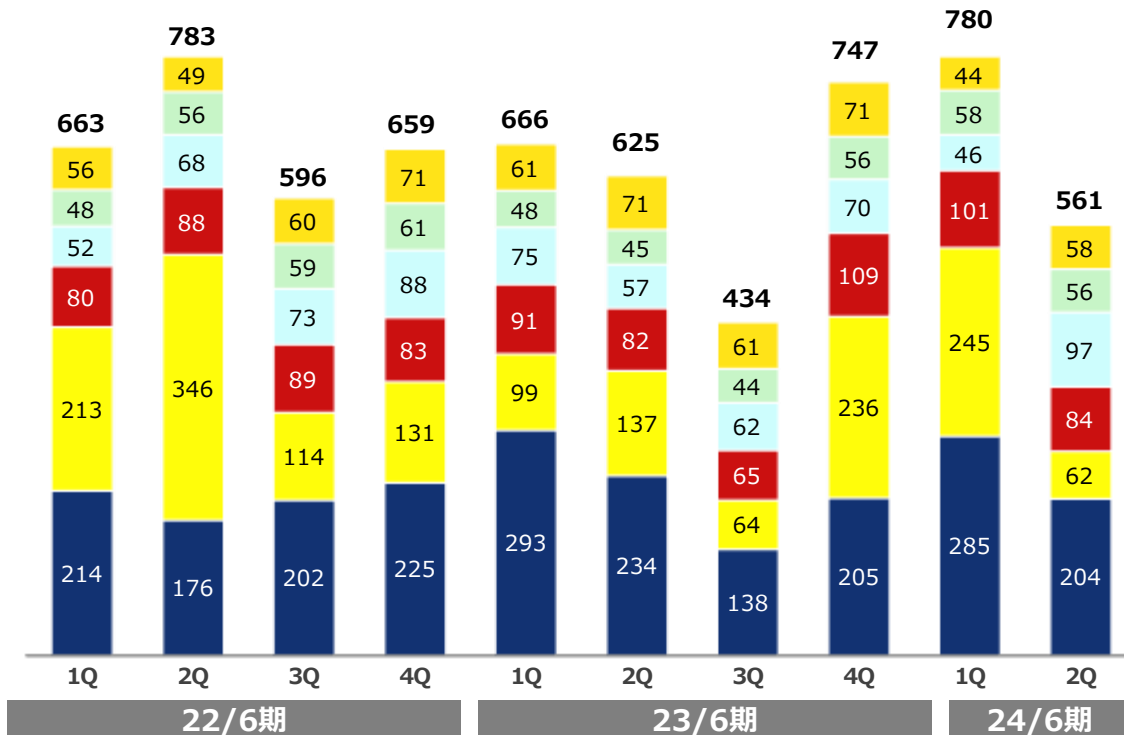
#### ULVACのコミュニケーション



資料の正確性に合わせたコミュニケーションツールも活用し、最適な情報開示を行っています。  
当社グループへの信頼を深めていただくため、決算情報を中心とした法定開示情報提供から、事業活動や経営戦略・財務情報に加え、企業価値を創出する上で欠かせない社会・環境への取り組み等の経営情報も記載した本レポートを、様々なコミュニケーションツールを通じて提供しています。なお、Webサイトでも最新の情報を提供していますので、あわせてご覧ください。

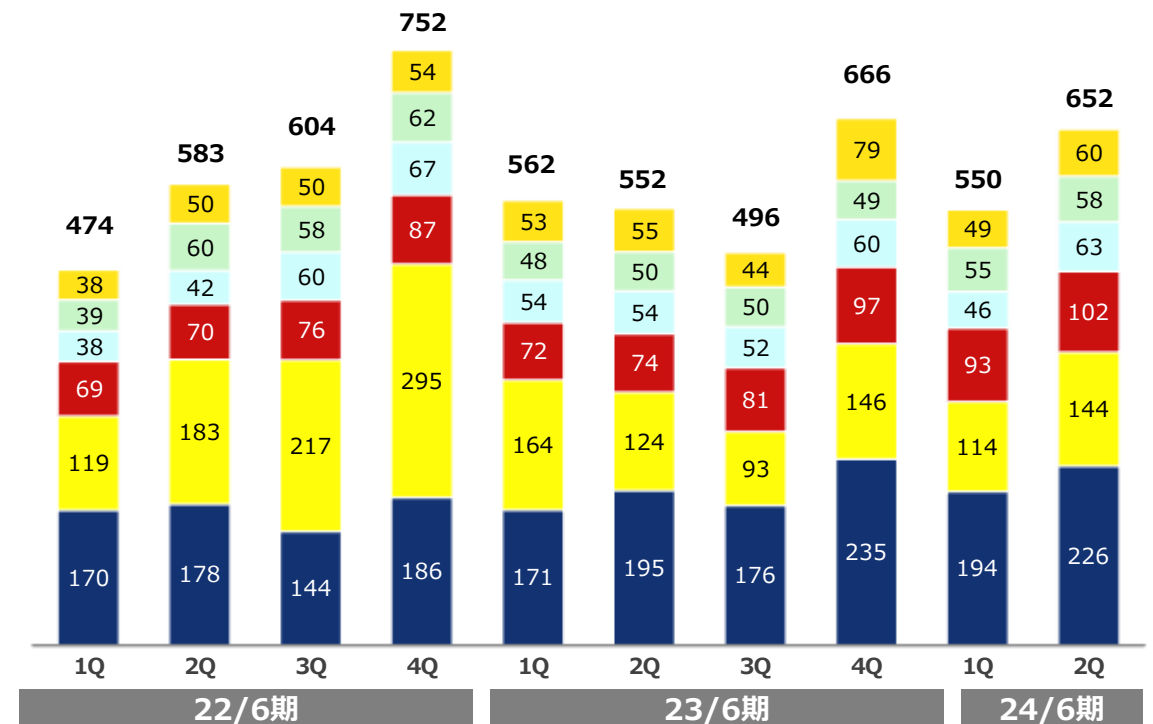
## 受注高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料  
■ FPD製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



## 売上高 【単位：億円】

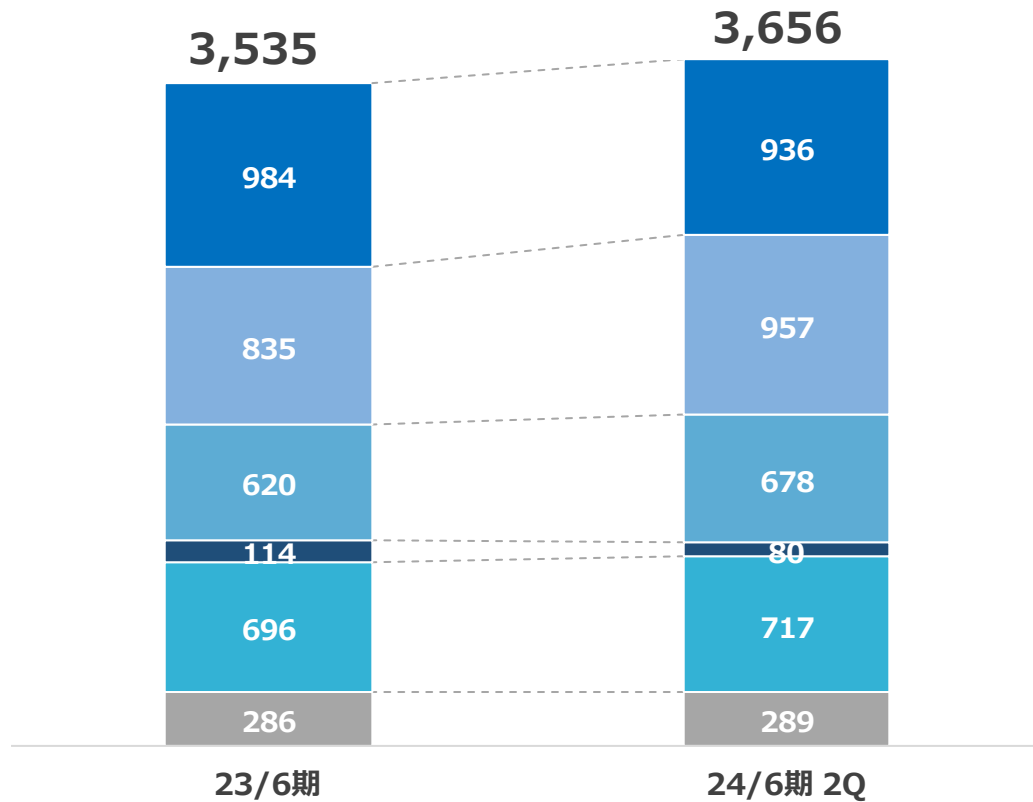
■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料  
■ FPD製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



## 資産

【単位：億円】

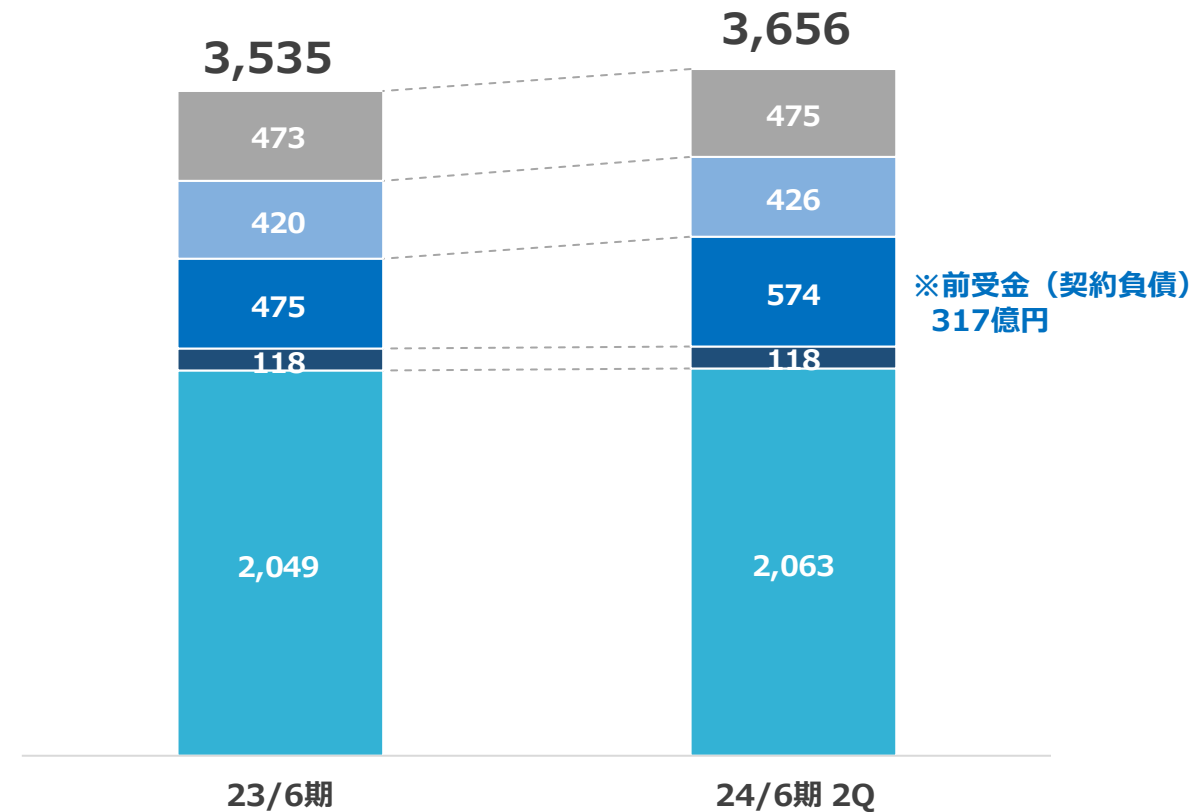
- 現金・預金
- 受取手形・売掛金
- 棚卸資産
- その他の流動資産
- 有形固定資産
- 投資有価証券 他



## 負債・純資産

【単位：億円】

- 支払手形・買掛金
- 有利子負債
- その他流動負債
- その他固定負債
- 純資産



## 社会的課題解決

スマート社会・  
デジタル社会実現グリーンエネルギー化  
低消費電力化

メモリ

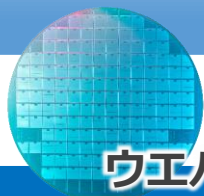
ロジック IC

センサー・電子部品

パワーデバイス

バッテリー

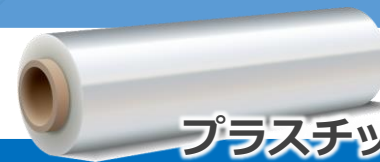
微細化 / 高性能化 / 低消費電力化



ウエハー



ガラス



プラスチック

## 真空薄膜形成技術

スパッタリング

蒸着

CVD

エッチング・アッシング

イオン注入

コンポーネント

マテリアル

カスタマーサポート

# さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術



**ULVAC**